



2025 年 4 月 17 日

各 位

上場会社名 株 式 会 社 ア マ ダ
代 表 者 代 表 取 締 役 山梨 貴昭
社 長 執 行 役 員
(コード番号 6113 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 常 務 執 行 役 員 三輪 和彦
財 務 部 門 長
電 話 番 号 0 4 6 3 — 9 6 — 1 1 1 1 (代 表)

ビアメカニクス株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、ビアメカニクス株式会社（以下「ビアメカニクス」といいます。）の発行済み株式の全てを株式会社アドバンテッジパートナーズ（以下「アドバンテッジパートナーズ」といいます。）がサービスを提供するファンド等から取得し連結子会社化すること（以下「本件株式取得」といいます。）について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件株式取得の理由

当社グループは、2030 年に目指す姿として「長期ビジョン 2030」を掲げると共に、持続的な成長と企業価値向上に向けた具体的なアクションプランとして、2025 年度（2026 年 3 月期）を最終年度とする 3 カ年の「中期経営計画 2025」を策定し、その実現に向けて全社で取り組んでおります。

当社は、金属加工機械メーカーとして当社の資産であるレーザ技術による新領域拡大を長期成長戦略の最も重要な活動の一つに位置付け、高い成長率が見込める e-Mobility、半導体、医療などの新分野への拡大、進出を目指し、当社が保有するレーザ技術の可能性や、その技術を活用した事業拡大について模索してきました。

一方、ビアメカニクスは、半導体業界におけるプリント基板、パッケージ基版の加工機市場において、特にハイエンド領域の生産性の高いドリル穴明機、超精密レーザ加工機の分野にて、業界トップクラスの技術力、様々な加工ニーズにワンストップで対応できる組織力を強みに国内外における加工機メーカーのリーディングカンパニーとして成長してきました。

当社としましては、ビアメカニクスをグループに迎えることにより、当社が保有するレーザ技術などのコア技術、自動化装置、IOT によるサービスサポート体制や生産供給体制の仕組み等と、ビアメカニクスが保有するレーザによる穴明加工技術や、製造装置を高速、高精度化する技術は、親和性が非常に高いと考えられること、更に同社が保有する半導体産業における顧客基盤の活用などによる事業機会の拡大、経営基盤の強化等、更なる企業価値向上を期待できるものと判断し、本件株式取得を行うことを決定いたしました。

当社グループは今後、当社が持つ自動化ソリューションとビアメカニクスが持つ高い技術を生かしたドリル穴明機や超精密レーザ加工機との相互補完関係を構築し、半導体業界の顧客基盤の大幅な拡充及びドリル穴明機やレーザ加工機をはじめとした高付加価値商品への資本の投下を実現してまいります。両社のシナジーを追求することにより当社グループのポジションをより強固なものとし、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

2. 異動する子会社（ビアメカニクス）の概要

(1)	名 称	ビアメカニクス株式会社		
(2)	所 在 地	神奈川県厚木市田村町 9 番 32 号		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 清水 秀晃		
(4)	事 業 内 容	半導体パッケージ基板及びプリント基板向けの高精度なドリル穴明機 / レーザ加工機の研究・開発、設計、製造、販売、サービス		
(5)	資 本 金	3 億 100 万円		
(6)	設 立 年 月 日	1968 年 8 月 17 日		
(7)	大株主及び持株比率	投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ VI 号		55.14%
		APCP VI, L.P.		23.35%
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	記載事項はありません	
		人 的 関 係	記載事項はありません	
		取 引 関 係	記載事項はありません	
(9)	当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態			
	決算期	2022 年 3 月期	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期
	連 結 純 資 産	14,092 百万円	22,179 百万円	20,620 百万円
	連 結 総 資 産	27,694 百万円	45,514 百万円	48,182 百万円
	1 株当たり連結純資産	3,705 円	5,832 円	5,422 円
	連 結 売 上 高	27,848 百万円	50,762 百万円	43,292 百万円
	連 結 営 業 利 益	4,060 百万円	10,653 百万円	6,771 百万円
	連 結 経 常 利 益	3,540 百万円	10,226 百万円	6,262 百万円
	親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	9,695 百万円	7,595 百万円	4,327 百万円
	1 株当たり連結当期純利益	2,549 円	1,997 円	1,138 円
	1 株 当 たり 配 当 金	—円	—円	2,297 円

3. 株式取得の主な相手先（売主）の概要

(1)	名 称	投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVI号		
(2)	所 在 地	東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号		
(3)	設 立 根 拠 等	投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合		
(4)	組 成 目 的	主として日本国内の会社等が発行する株式及び株式関連証券に対する投資を行うこと		
(5)	組 成 日	2020 年 3 月 25 日		
(6)	出資約束金額の総額	48,783,000,000 円		
(7)	出 資 者 ・ 出 資 比 率 ・ 出 資 者 の 概 要	AP VI GP 投資組合 1 % その他の出資者については、銀行、保険会社、年金基金、事業会社等で構成されておりますが、具体的な名称及び出資比率の記載については売主の方針により控えさせていただきます。		
(8)	業務執行組合員の概要	名 称	AP VI GP 投資組合	
		所 在 地	東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 28 号	
		代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	業務執行組合員 株式会社 AP VI GP 代表取締役 笹沼 泰助	
		事 業 内 容	投資事業組合財産の運用及び管理	
		出資約束金額	483,000,000 円	

(9) 国内代理人の概要	名 称	—
	所 在 地	—
	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	—
	事 業 内 容	—
	資 本 金	—
(10) 上 場 会 社 と 当 該 ファンドとの間の関係	上 場 会 社 と 当 該 フ ァ ン ド との間の関係	該当事項はありません
	上場会社と業 務執行組員 との間の関係	該当事項はありません
	上 場 会 社 と 国 内 代 理 人 との間の関係	該当事項はありません

(注) 上記のほか、株式取得の相手先にアドバンテッジパートナーズの系列ファンド4社及び個人株主1名がありますが、重要性に乏しいため記載を省略しております。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0.0%)
(2) 取 得 株 式 数	3,923,680株 (議決権の数：39,236個)
(3) 取 得 価 額	51,000百万円 なお、アドバイザリー費用等については未定のため、含めておりません
(4) 異動後の所有株式数	3,923,680株 (議決権の数：39,236個) (議決権所有割合：100.0%)

(注) 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズVI号等以外の少数株主が保有する潜在株式が存在するものの、株式譲渡実行日までの間に普通株式へ転換され、当該株式についても当社が取得する予定です。そのため、「(2) 取得株式数」及び「(4) 異動後の所有株式数」は当該転換後の普通株式の数も含めております。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2025年4月17日
(2) 本件株式取得の契約締結日	2025年4月17日
(3) 本件株式取得の実行日	2025年7月(予定)

(注) 本件株式取得の効力発生は、国内の独占禁止法その他関連法令上必要な承認等の手続きが完了することを条件としております。これら手続きの遅延又はその他の理由により上記日程が変更となる場合があります。

6. 今後の見通し

本件株式取得に伴い、ピアメカニクスは2026年3月期第2四半期より当社の連結子会社となる予定です。なお、本件株式取得による当社の連結業績に与える影響は精査中であり、今後業績に影響を与える事項が発生した場合には速やかに開示いたします。

以 上



ビアメカニクスの買収について

Growing Together with Our Customers

半導体市場への本格参入と新たなレーザ加工技術の共創

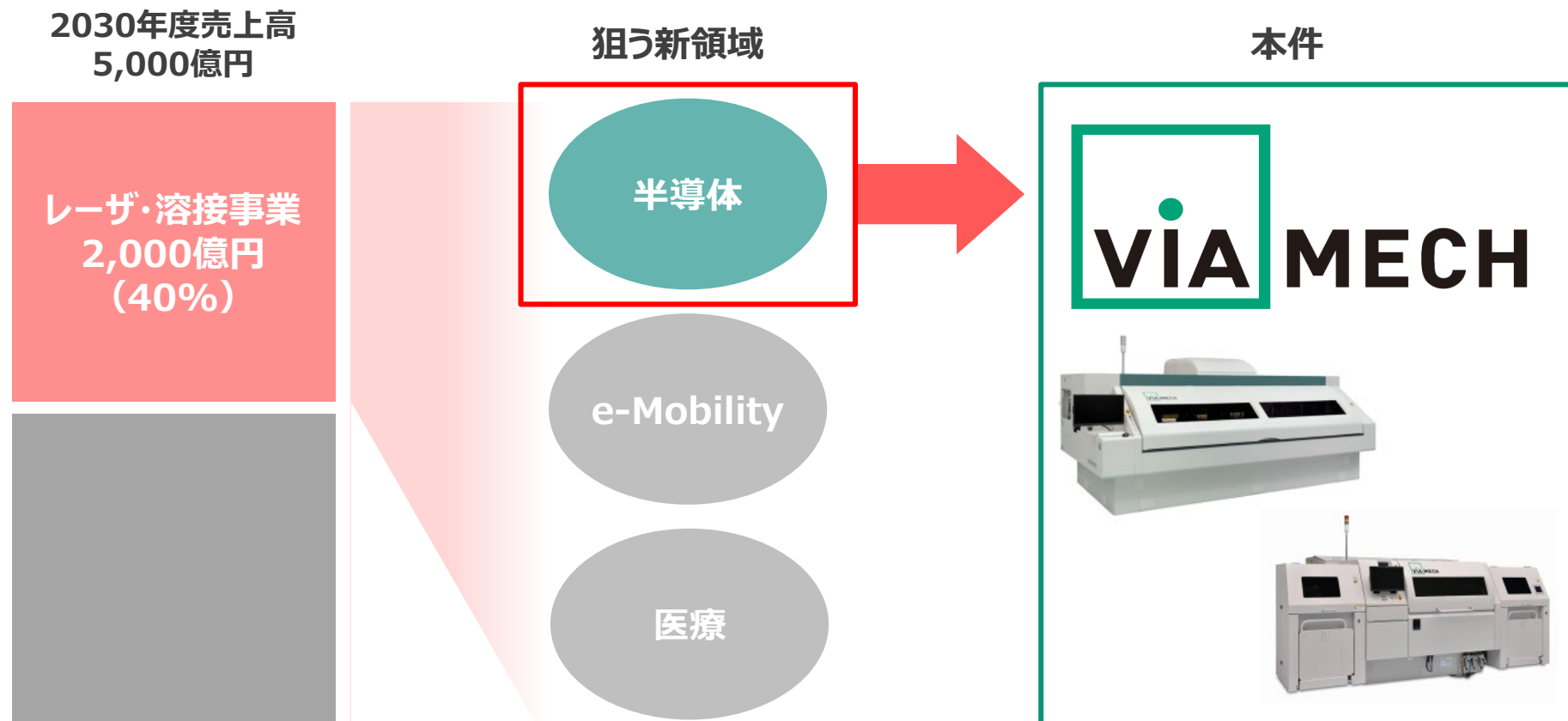
株式会社アマダ

代表取締役社長執行役員 山梨 貴昭

2025年4月17日



レーザ技術で
新たなステージへ

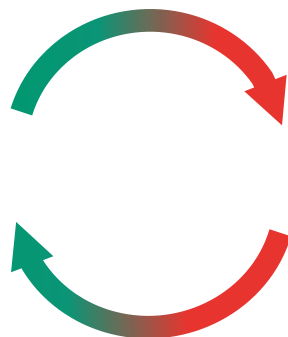


レーザ技術を基軸として
中期経営計画で狙う新領域の一つであった半導体分野に進出



基板穴あけ
ソリューション

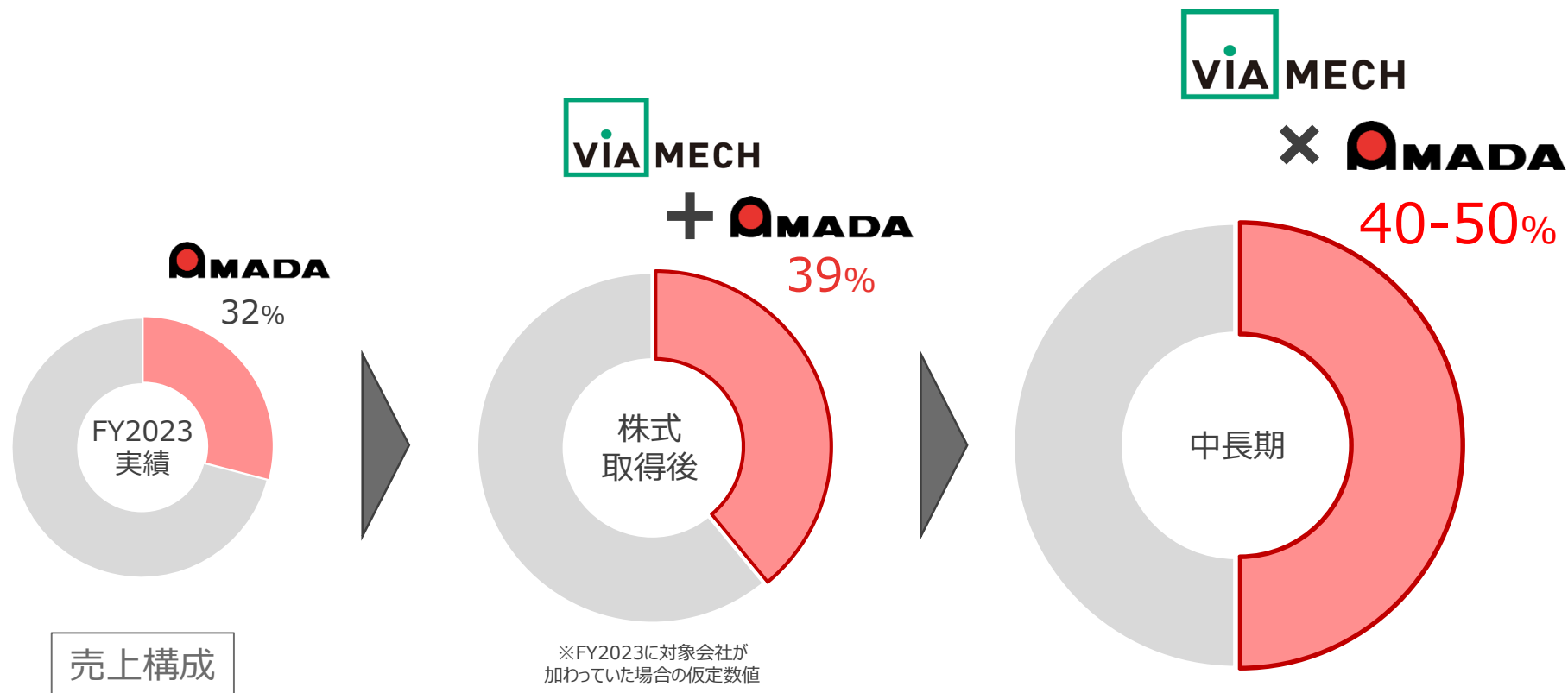
強固な
顧客基盤



レーザ・
自動化
技術

生産供給
サポート体制

双方の強みを活かし、
半導体産業の発展に貢献していく



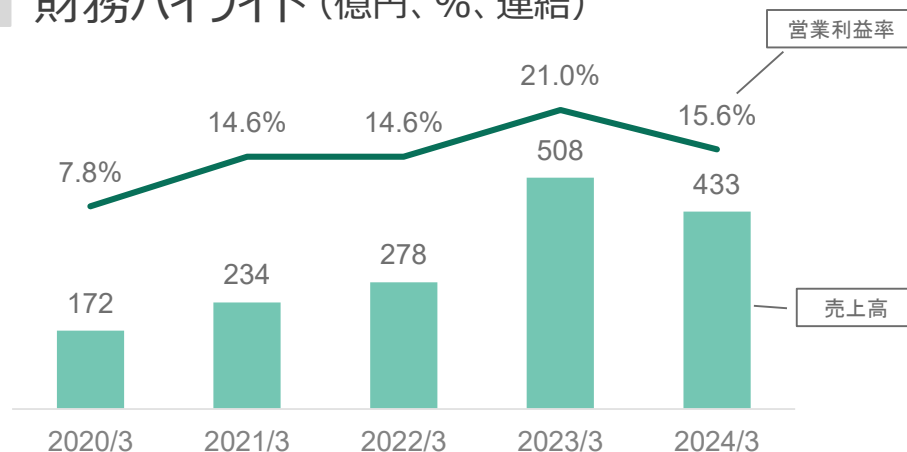
ビアメカニクスとのシナジーを最大限に発揮させ、
中長期でレーザ事業を全社売上比40～50%の中核事業へ

ビアメカニクスは世界最先端の基板穴あけ加工機械メーカー

会社概要

名称	ビアメカニクス株式会社
代表者	代表取締役社長 清水 秀晃
設立	1968年8月
所在地	神奈川県厚木市田村町9番32号
事業内容	半導体パッケージ基板およびプリント基板向けの高精度なドリル穴あけ機 レーザ加工機の研究・開発、設計、製造、販売、サービス
従業員数	562名（24/3期、連結）

財務ハイライト（億円、%、連結）



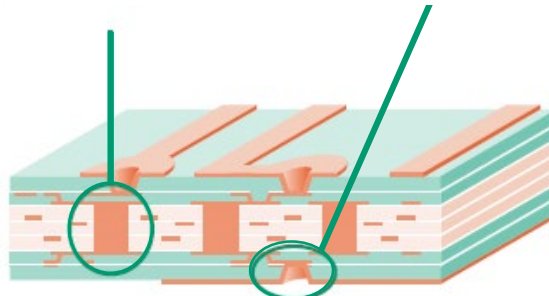
製品概要

ドリル穴明機



ドリル加工

レーザ加工



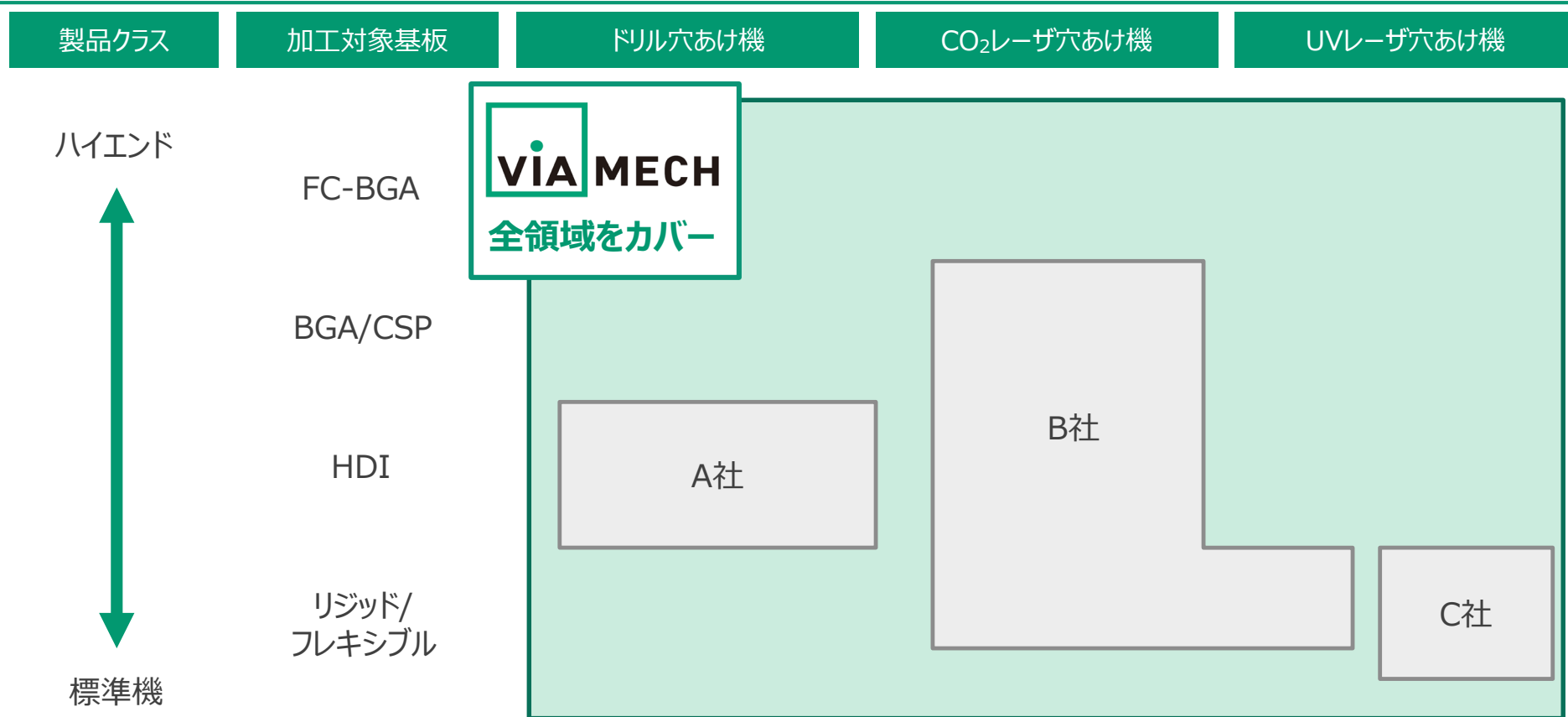
レーザ加工機



PCBイメージ図

ドリル及び各種レーザ（CO₂,UV）の幅広いラインナップにより、
お客さまニーズに応じた最適なソリューションをワンストップで提供可能

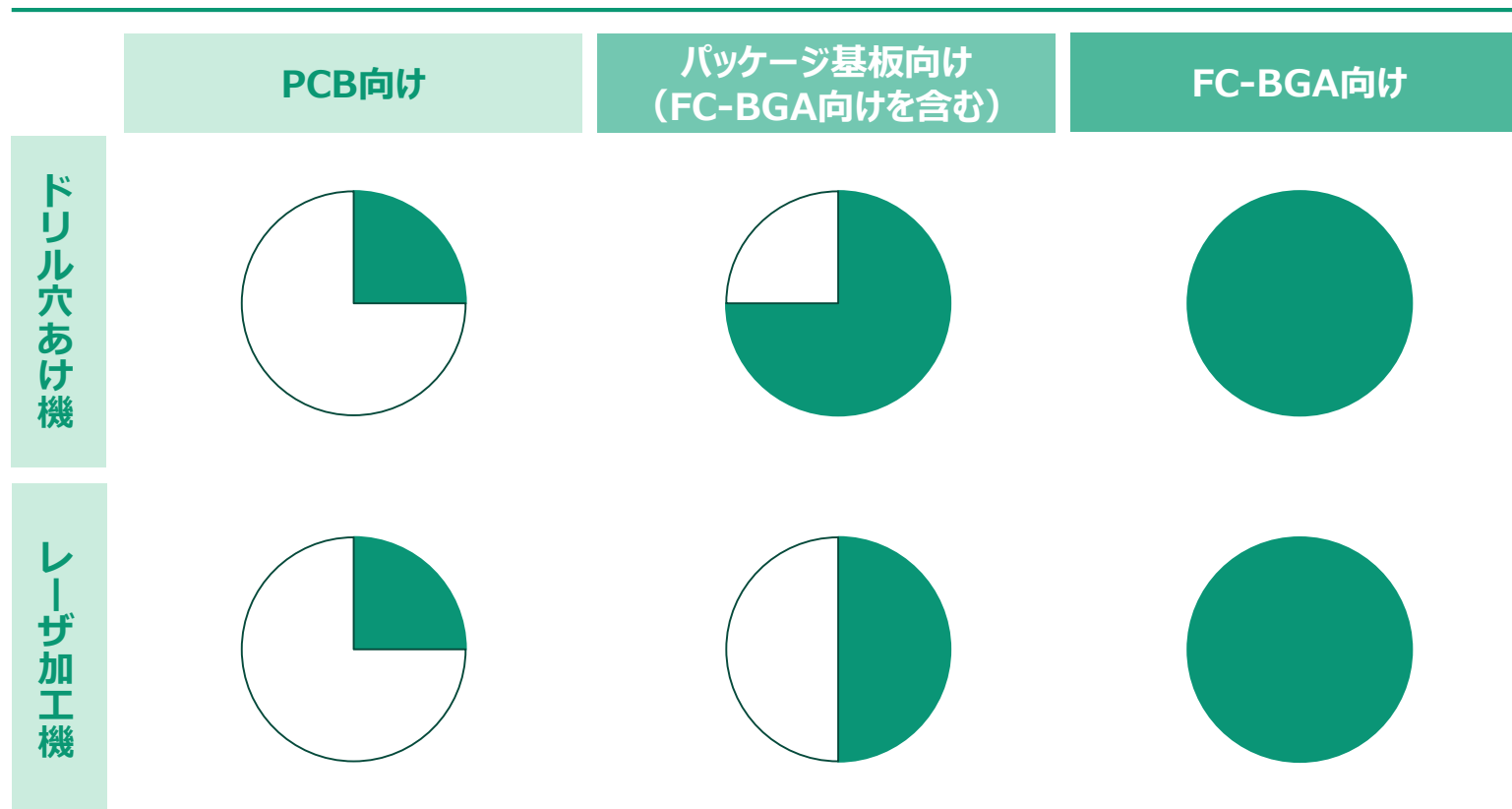
主要基板穴あけ装置メーカーにおける各装置の取り扱い状況¹（イメージ図）



1. 独自の分析に基づくイメージ図であり、実際の取り扱い状況を正確に表示していない可能性がある。

お客さま並びに市場に世界トップの技術を提供することで、
ドリル穴あけ機、レーザ加工機共にハイエンド領域で圧倒的なシェアを占める

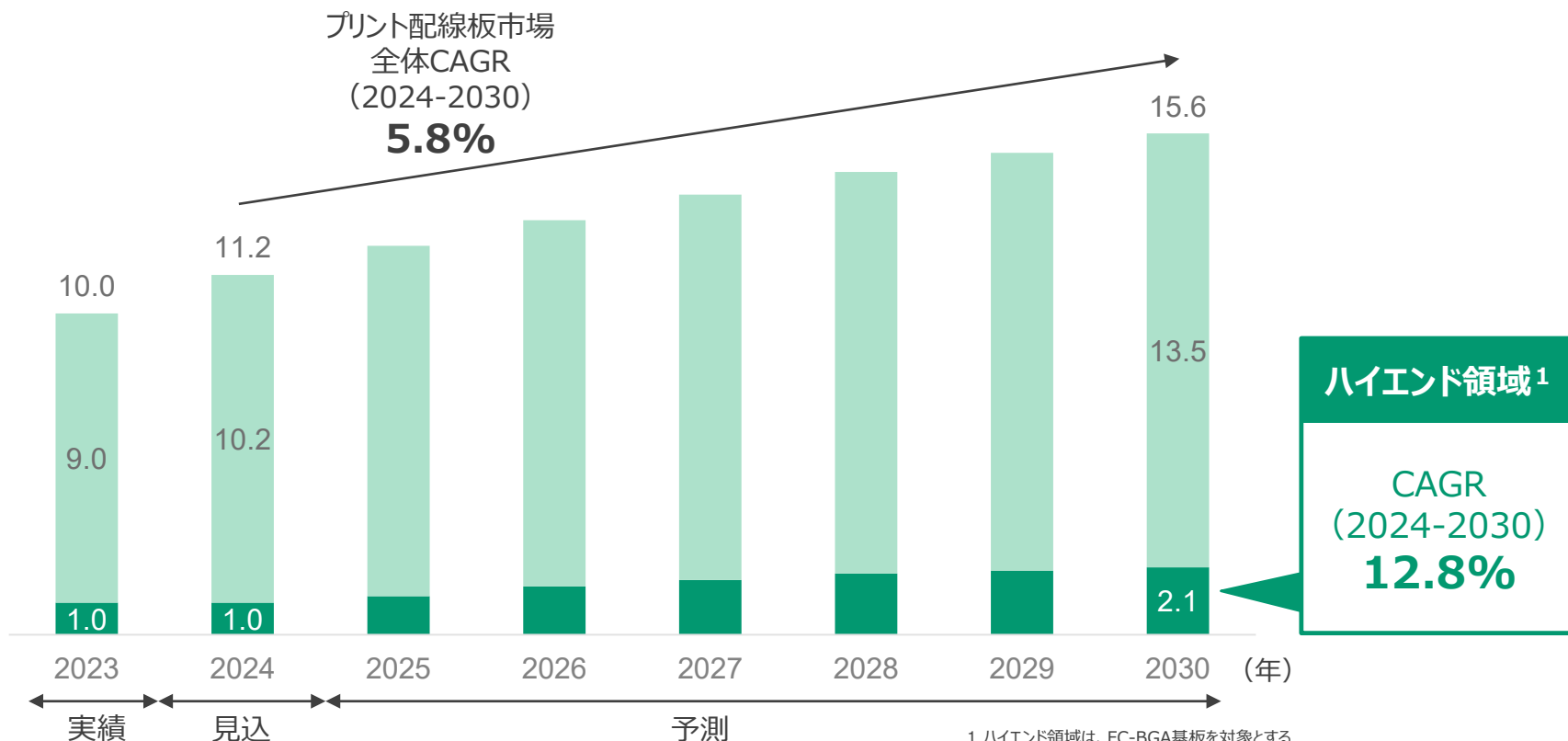
市場シェア（イメージ図）



 : ビアメカニクスのシェア・ポジショニング（4段階評価、緑がビアメカニクスを指す）

データ量の増加等を背景に、プリント配線板市場は中長期的な成長が見込まれ、特にAIサーバなど高機能向けのハイエンド領域は高い成長が予想

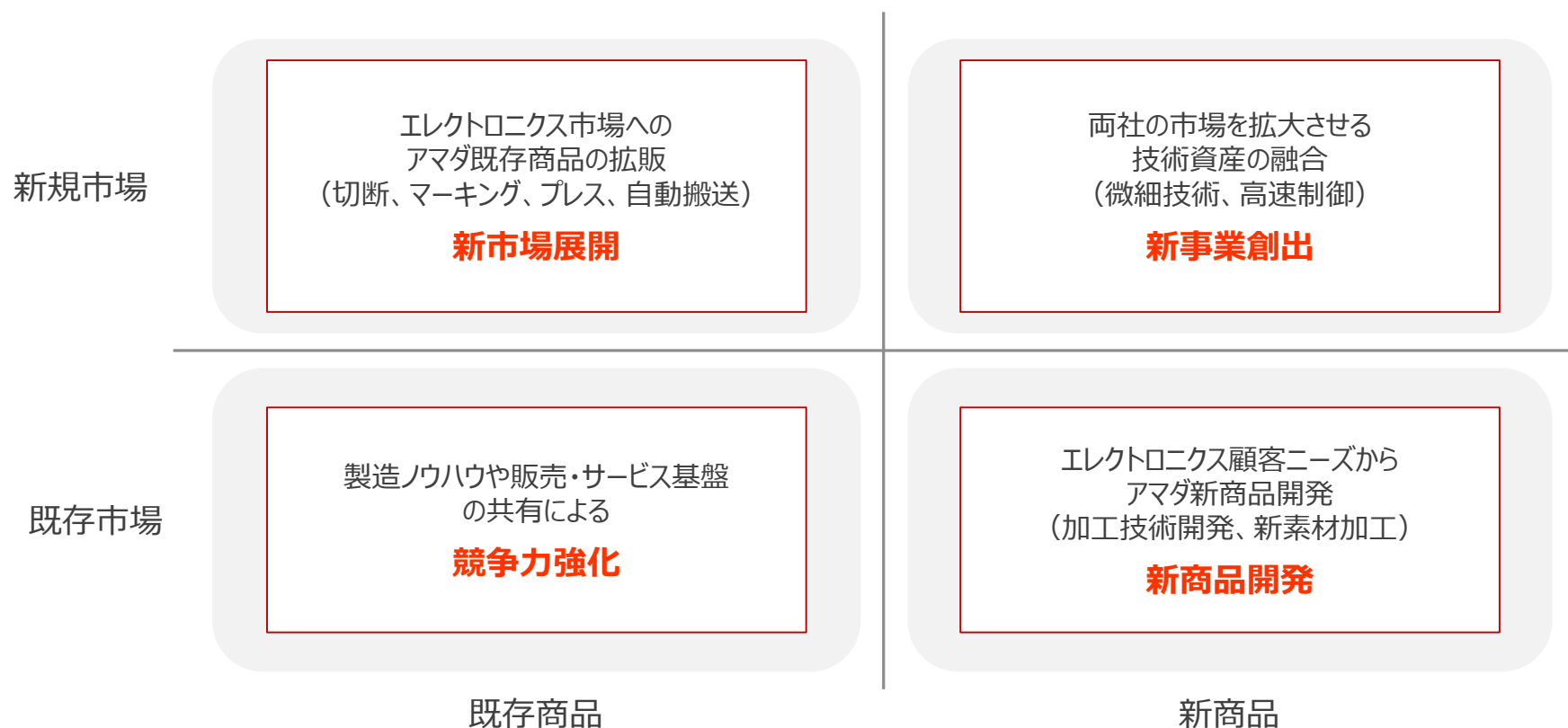
プリント配線板の市場動向（2023-2030、兆円）



1. ハイエンド領域は、FC-BGA基板を対象とする

出典：富士キメラ総研「2024 エレクトロニクス実装ニューマテリアル便覧」

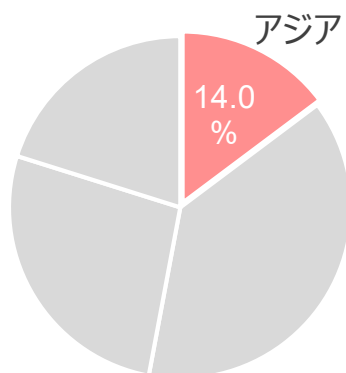
両社の既存領域のシナジーだけでなく、新規領域においても
それぞれの技術・ノウハウを活用した事業創出を目指す



ビアメカニクス取得により、成長市場であるアジア地域を拡充し、
一層の企業価値向上と社会貢献を追求

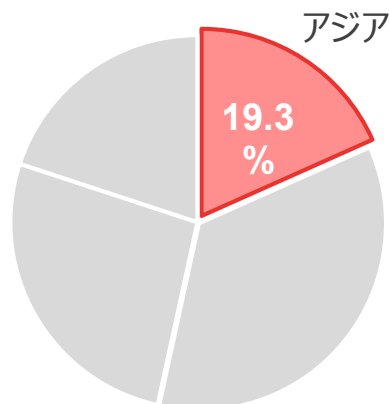
連結売上高に占めるアジア事業の割合

FY2023実績



株式取得後

※FY2023に対象会社が
加わっていた場合の仮定数値

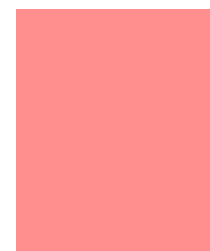


アジア地域向け売上高割合
+5.3%

連結ROEへのインパクト

FY2023実績

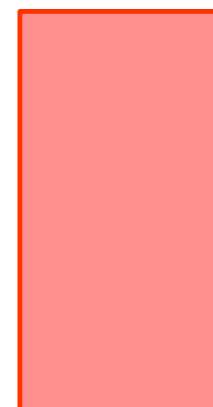
7.9%



株式取得後

※FY2023に対象会社が
加わっていた場合の仮定数値

8.7%



連結ROE
+0.8%

対象企業	ビアメカニクス株式会社
買収価額	510億円（アドバイザリー費用等については未定のため含まれていない）
ストラクチャー	現金対価で対象会社株式を100%取得
資金調達	買収資金は全額借入金にて対応
スケジュール	2025/4/17 株式譲渡契約の締結 2025/7月 クロージング予定



本資料、プレゼンテーション及び質疑応答の際の回答には、将来の業績見通しや戦略が含まれ、これらは現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断に基づいております。これらの将来的予測に基づく記載や発言は将来の実績を保証するものではなく、実際の結果が製品に対する需要変動、為替変動、金利変動などの様々な要素により、業績見通しとは異なりうることをご承知おき下さい。